

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2006年1月12日 (12.01.2006)

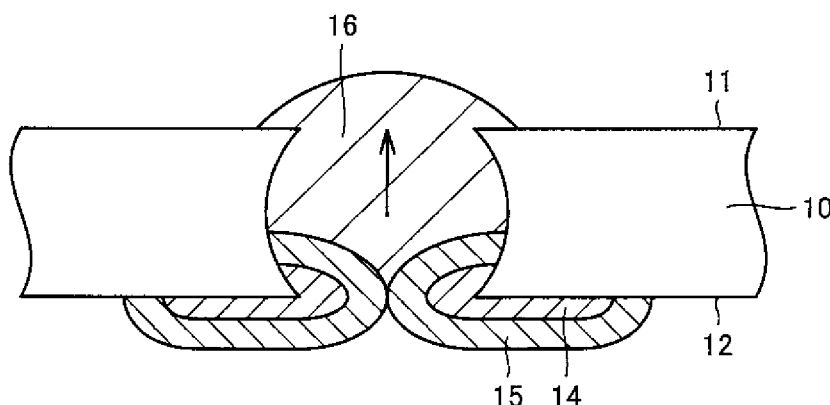
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/004127 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 23/32 (74) 代理人: 伊藤 英彦, 外(ITHO, Hidehiko et al.); 〒5420082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目21番19号 協和島之内ビル アイミー国際特許事務所 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/012424
- (22) 国際出願日: 2005年7月5日 (05.07.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-199785 2004年7月6日 (06.07.2004) JP
特願2004-199870 2004年7月6日 (06.07.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 加川 健一 (KAGAWA, Kenichi) [JP/JP]; 〒2110006 神奈川県川崎市中原区丸子通2-707-7 ロワール新丸子703 Kanagawa (JP). 星野 智久 (HOSHINO, Tomohisa) [JP/JP]; 〒6600891 兵庫県尼崎市扶桑町1-8 東京エレクトロンAT株式会社内 Hyogo (JP). 八壁 正巳 (YAKABE, Masami) [JP/JP]; 〒6600891 兵庫県尼崎市扶桑町1-8 東京エレクトロンAT株式会社内 Hyogo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
— 補正書・説明書
- 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: INTERPOSER AND INTERPOSER PRODUCING METHOD

(54) 発明の名称: インターポーザおよびインターポーザの製造方法



(57) Abstract: An interposer producing method comprises the steps of forming a seed layer (14) in the opening in a through-hole (13) on the back (12) side of a base plate (10), forming a plating electrode layer (15) on the basis of the seed layer (14), and forming a plated layer (16) on the face (11) side of the base plate (10) to fill the through-hole (13). As a result, it is possible to provide an interposer producing method in which the production process is easy and no blowhole is produced in the through-hole.

(57) 要約: インターポーザの製造方法においては、基板10の裏面12側の貫通孔13の開口部にシード層14を形成し、そのシード層14を基にメッキ用電極層15を形成し、そこから、基板10の表面11側にメッキ層16を形成して貫通孔13を埋める。その結果、製造工程が簡単で、かつ貫通孔の内部に巣が生じない、インターポーザの製造方法を提供できる。